1-6-2-2　捨て基板部残銅／板边的残余铜 / Residual copper on board border area

【特徴】捨て基板部に残銅が存在する状態の欠陥

【特征】板边存在残余铜的缺陷。

【Characteristics】Residual copper left on board border area

【コメント】
顕微鏡倍率×

【注释】
显微镜倍率 ×

[Coments]
Magnification: ×

【コメント】
顕微鏡倍率×

【注释】
显微镜倍率 ×

[Coments]
Magnification: ×

【原因・判断ポイント・発生工程】ＥＴ前の捨て基板部にＥＴレジストになる何らかの粘着性異物が付着したために出来たもの、あるいは輔基板部に露光して出来たもの（露光工程、ＥＴ工程）

【原因、判断要点、发生工序】在 ET 前板边附着某种粘性杂物成为 ET 剂所引起的、或者板边曝光引起的（曝光工序、ET 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】Some tacky foreign object attached to a border area before etching acts as an etching resist, or unwanted exposure is made in the photographic process to the border area to cause the defect. (Imaging and etching process)

1-7　太り／线粗 / Expanded copper

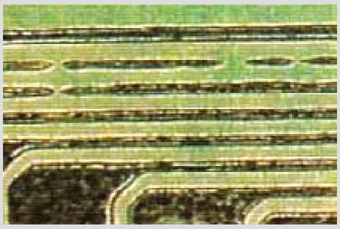
1-7-1　異物起因（太り）／杂物起因（线粗）/ Caused by foreign objects(expanded copper)

1-7-1-1　露光被り太り／曝光灰雾的线粗 / Expanded conductor by photographic fogging

【特徴】単独の部分的な太り。極稀に同一個所太りが複数見られる場合もある

【特征】单独的局部的线粗。有时也可看到同一个部位的多条线粗，但是，为数很少。

【Characteristics】Partially expanded isolated conductor. More than one expanded portions at an area are observed very rarely.



【コメント】
短絡と同居
顕微鏡倍率× 40

【注释】
与短路并存
显微镜倍率 × 40

[Coments]
Coexists with short
Magnification: ×40